



产品简介

- KXS320-6.0是一款双组份、加成型有机硅导热灌封胶。该产品粘度较低，流动性好，使用简单方便；其固化物具有高导热性，阻燃性，可在-60℃~+220℃范围内长期使用；能够对电子元器件及模组起到良好的密封、绝缘保护及散热作用。

产品特点

- 可室温或加温固化
- 粘度较低，施胶操作性好
- 耐高低温，可耐受-60~220℃
- 优异的导热性能

联系我们：张 艳：138-5168-3378；
荣 岩：180-6607-5325；田晓冰：152-5095-2541；
许飞艳：132-7663-5250；杨慧子：159-9624-3638

典型性能

固化前性能	检测项目	参考标准	单位	典型数值	
	外观	目测	/	A组份	灰色流体
				B组份	白色流体
	粘度	ASTM D2196	cps	A组份	30000-50000
				B组份	30000-50000
	密度	ASTM D792	g/cm³	A组份	3.30±0.05
B组份				3.30±0.05	
混合后性能	配比（重量比或体积比）		/	1:1	
	混合后粘度	ASTM D2196	cps	30000-50000	
	可操作时间	SLQB-01	min	40-90	
	初固时间	SLQB-02	h	4-6	
	固化时间	SLQB-03	h	@25℃	24
			min	@80℃	30-60
固化后性能	外观	目测	/	灰色固体	
	硬度	ASTM D2240	Shore-A	≥35	
	密度	ASTM D792	g/cm³	3.30±0.05	
	介电强度	ASTM D149	KV/mm	≥15	
	体积电阻率	ASTM D257	Ω.cm	>1*10 ¹³	
	导热系数	ASTM D5470	W/mk	6.0	





使用方法：

- **混合前：**先将A、B组份分别搅拌均匀。
- **混合：**按重量比A：B=1：1，准确称量两组份放入干净的容器内搅拌均匀。搅拌应采用专用刮刀，刮刀宽度不小于1.5cm，胶料量大时，用较小的刮刀搅拌，不容易搅拌均匀。搅拌时，刮刀先顺时针搅拌1min后，再逆时针搅拌1min（胶料较多时，搅拌时间应延长）；搅拌过程中，应用刮刀反复刮动容器底部、边沿、角落、壁部的物料，并将容器中的物料上下翻搅2-3次，确保物料的颜色和状态均匀一致，即为搅拌均匀。
- **脱泡：**可自然脱泡和真空脱泡，自然脱泡：将混合均匀的胶静置10-15分钟，真空脱泡：真空度为0.08-0.1MPa，抽真空5-10分钟。
- **灌注：**应在操作时间内将胶料灌注完毕，否则影响流平。如需灌好胶后，再真空脱泡时，单次灌胶的高度最好不要超过1cm,如灌胶高度大于1cm时，建议分多次灌胶排泡。注意：每次灌封前基材表面保持清洁和干燥。
- **固化：**室温或加热固化均可。温度升高，固化速度变快。气温低时，建议采用加热方式固化。

注意事项：

- 远离儿童存放。
 - 胶料密封贮存。混合好的胶料一次用完，避免造成浪费。
 - 本品属非危险品，但勿入口和眼。
 - 胶液接触一定量的以下化学物质会不固化：
 - N、P、S有机化合物。
 - Sn、Pb、Hg、As等元素的离子性化合物。
 - 含炔烃及多乙烯基化合物。
- ✓ 为了避免上述现象，所以在线路板上使用时尽量擦干净上面残留的松香，尽量使用低铅含量的焊锡。

包装规格、储存与运输：

- **包装规格：**
 - 2kg/套（A组份：1kg/罐；B组份：1kg/罐）；
 - 30kg/套（A组份：15kg/桶；B组份：15kg/桶）；
 - 其他规格可以根据客户需求进行订制；
- **储存：**最佳储存温度：≤30℃，有效期：12 个月。
- **运输：**此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

